

# SOLCHEM 激光焊接针筒锡膏

激光焊接锡膏适用于激光和烙铁的快速焊接，焊接时间最短可以达到 300 毫秒，快速焊接过程无溶剂挥发，焊接过程中不飞溅，焊接过后焊点饱满没有锡珠残留，完全可以省掉清除锡珠的工序。本品有不同熔点的焊接温度，颗粒有 20-38UM、15-25UM、10-20UM。采用水洗纯水可清洗掉助焊剂，可采用不同的针头内径点锡膏不堵针头采用针管送样,湿度 40~60%RH。该产品为零卤素配方，有机残留物极少，且呈透明状，表面阻抗高，可靠性高。

合金型号	粉径	熔点	适用行业
Sn64Bi35Ag1	4#	178°C	摄像头模组、VCM 音圈马达、CCM 烙铁, 天线, 硬盘磁头、扬声器、喇叭、光通讯元器件、热敏元件、光敏元件等传统方式难以焊接的产品。
Bi58Sn42	3# 4#	138°C	
Sn96.5Ag3Cu0.5	4# 5# 6#	217°C	
Sn99Ag0.3Cu0.7	4# 5#	217°C—227°C	

## 应用工艺

点胶涂布

针转移

## 焊接工艺

激光高温瞬间焊接

## 包装

10cc

30g

30cc

100g

55cc

200g

